

スイッチ高さ 0.6mm ダブルアクションタクティールスイッチ TSW-24 シリーズ

特長

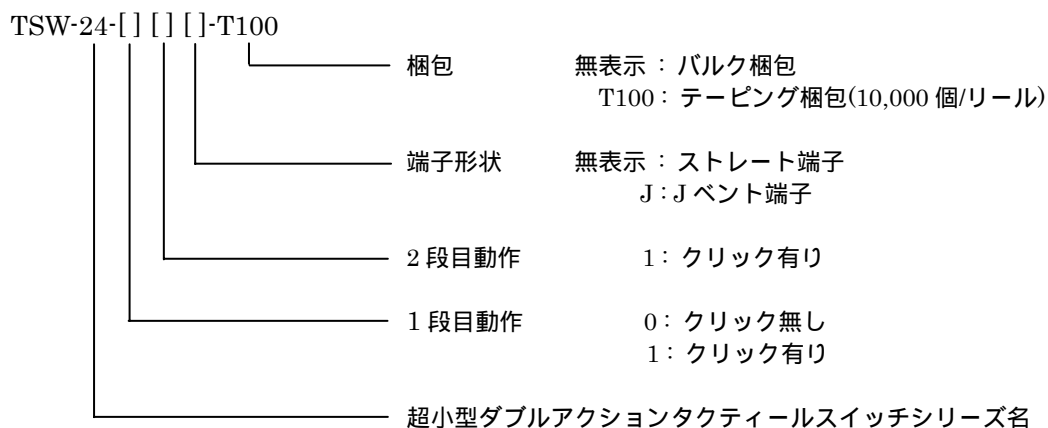
外形サイズ 3.8x3.8mm、高さ 0.6mm で高密度実装に適した表面実装タイプ。
 当社 TSW-15 シリーズ比、実装面積 32%減、スイッチ高さ 20%減、体積 54%減と省スペース薄型化を実現。
 最初のプッシュ操作によって、1 段目が ON し、さらに押すと 2 段目も ON する、1 回路 2 接点のダブルアクションタイプ。
 1 段目動作時のクリック有りタイプ (0.8N)・クリック無しタイプをシリーズ化。
 全品種、静電気放電対策に有効なアース端子付き。
 キータッチはタクティールフィードバック特性を活かしたシャープなクリック感触。
 端子形状は J ベント、ストレート端子をシリーズ化、リフローハンダ付けが可能。
 スwitchの供給は、12mm 幅エンボステーピング方式。

用途

デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
 ポータブルオーディオ、カーナビ
 携帯電話、携帯情報端末



品番体系



主な仕様

項目	仕様
最大定格(抵抗負荷)	50mA 12V DC
接触抵抗	100mΩ max. (初期値)
絶縁抵抗	100MΩ min. 500V DC
耐電圧	100V AC for 1min.
作動力	1 段目クリック有り ; 1 段目 0.8N , 2 段目 2.0N 1 段目クリック無し ; 1 段目 <0.3N , 2 段目 1.5N
動作寿命	50,000 cycles
使用温度範囲	-20 to +70
保存温度範囲	-30 to +80 (梱包資材除く)

製品一覧

1 段目クリック有りタイプ

No	製品番号	1 段目作動力	2 段目作動力	動作位置 (基板面からの距離)	端子形状
1	TSW-24-11-T100	0.8N	2.0N	1 段目 0.45mm	ストレート
2	TSW-24-11J-T100			2 段目 0.3 mm	J-ベント

1 段目クリック無しタイプ

No	製品番号	1 段目作動力	2 段目作動力	動作位置 (基板面からの距離)	端子形状
1	TSW-24-01-T100	< 0.3N	1.5N	1 段目 0.4 mm	ストレート
2	TSW-24-01J-T100			2 段目 0.25mm	J-ベント

外形図

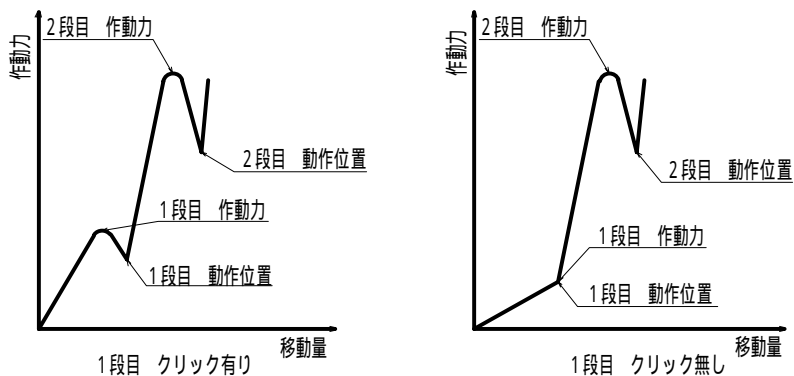
単位 : mm

No	形状	P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
1	ストレート端子 	<p>※基板パターンにてB-D間を繋いでください。 B and D are connected by pattern.</p> <p>□ ランド指定領域 Pattern prohibition area</p> <p>▨ ランドパターン禁止領域 Pattern prohibition area</p> <p>プリント基板ランド推奨寸法 Land dimentionls</p> <p>Free 1st ON 2nd ON</p> <p>CIRCUIT</p>

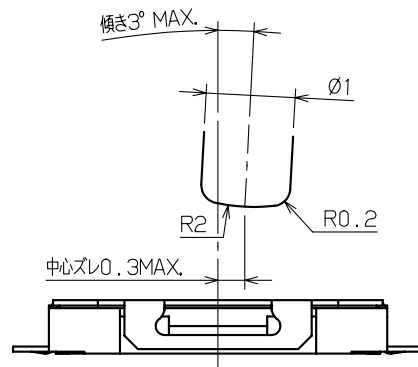
単位 : mm

No	形状	P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
2	<p>J ベント端子</p>	<p>P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)</p> <p>※基板パターンにてB-D間を繋いでください。B and D are connected by pattern.</p> <p>□ ランド指定領域 Pattern prohibition area</p> <p>⊗ ランドパターン禁止領域 Pattern prohibition area</p> <p>プリント基板ランド推奨寸法 Land dimensions</p> <p>CIRCUIT</p>

作動力チャート



推奨押し棒先端形状 / 操作条件



打鍵部推奨条件
Push part conditions

注記

1. 製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
2. 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
3. 別紙に掲載の『スイッチの使用上の注意』をご確認をお願いします。
4. テーピング梱包仕様は 10,000 個/リールが最小梱包単位となります。ご注文につきましては最小梱包単位の N(整数)倍でご発注いただけますようご協力お願い致します。
5. リフロー条件の設定については、実際の量産条件で御確認ください。
6. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては、十分考慮願います。
7. 本ブッシュスイッチは、洗浄タイプではありませんので洗浄は行わないでください。
8. 本ブッシュスイッチは、リフロー半田対応であり、使いかたて上基板の端に位置するケースが考えられますが、この場合スイッチ実装後にオートディップを行ないますと、フラックスが、スイッチ接触部へ入り込む危険性がありますのでスイッチ実装後にオートディップは行わないで下さい。
9. スイッチ操作時に規定以上の静荷重及び衝撃荷重を加えないで下さい。
10. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押すことは避けて下さい。
11. 手付けハンダを行う場合、ハンダゴテは端子先端にあて端子に異常加圧のない様ご配慮願います。尚、ハンダ付け後、1分間はスイッチに力を加えない様願います。
12. 端子部にフラックス等の侵入のない様ご配慮願います。
13. カバー上面に力が加わると動作特性が変化しますので、加圧がない様ご配慮願います。